

## 第 29 回電子デバイス界面テクノロジー研究会 –材料・プロセス・デバイス特性の物理– (EDIT29) スポンサーシップ募集のご案内

第 29 回電子デバイス界面テクノロジー研究会 –材料・プロセス・デバイス特性の物理– (EDIT29) は 2024 年 1 月 31 日 (水) ~2 日 (金) に東レ総合研修センター (静岡県三島市) で開催予定です。なお、オンライン Live 配信を併せたハイブリッド開催を予定しております。EDIT29 では本研究会をご支援いただける企業様に対して、以下のような企業展示・広告掲載も含めたスポンサーシップの募集をしております。是非ご検討頂きますよう、お願いとご案内を申し上げます。

### 【研究会内容】

1. 日時： 2024 年 1 月 31 日(水)~2 月 2 日(金)
2. 場所： 東レ総合研修センター (静岡県三島市) およびオンライン Live 配信
3. 研究会スコープ： Si テクノロジー・パワー半導体・新材料・薄膜界面・プロセス技術
4. 研究会規模： 100~140 名程度  
2023 年実績：133 名 (現地 107 名、オンライン 26 名、ハイブリッド開催)  
2022 年実績：135 名 (オンライン開催)
5. 参加者内訳：  
2023 年実績：大学 (一般 4 割, 学生 2 割), 民間企業 3 割, 国立研究機関 1 割  
2022 年実績：大学 (一般 4 割, 学生 2 割), 民間企業 3 割, 国立研究機関 1 割

### 【EDIT29 スポンサーシップ・予稿集広告+ウェブ広告セット】

- ✓ 料金：1 口あたり 50,000 円
- ✓ 1 口 5 万円で、以下の①~⑤の特典をご利用いただけます。

#### ① 1 名参加無料

- ✓ 1 口あたり 1 名の方に参加費無料で研究会にご参加いただけます。

#### ② 予稿集 (PDF 形式) への広告掲載

- ✓ 参加者がダウンロードする予稿集 PDF に広告を掲載いたします。冊子印刷はありません。
- ✓ A4 サイズ縦向き 1 ページ (1 口あたり)。カラー/白黒可
- ✓ 原稿締め切りは 12 月 15 日 (金) を予定しております。
- ✓ ファイル (pptx, pdf 形式など) を担当者にメール添付などによりご送付ください。

#### ③ 研究会ウェブサイトへ貴社のロゴと HP リンクを掲示 + オンライン展示会

- ✓ 研究会ウェブサイトのトップページ (<http://edit-ws.jp/>) に貴社のロゴをバナー形式で掲載させていただきます (掲載期間、2024 年 10 月末日までを予定)。貴社のウェブサイトへのリンクを貼ることが可能です。
- ✓ オンライン企業展示会のページ (<https://edit-ws.jp/exhibition/>) にて、貴社の商品カタログ (PDF) や、画像、YouTube 動画リンクなど、ファイルを自由に置いていただけます。
  - ・ 最大 12 ファイル程度を目途に担当者にメール添付などによりご送付ください。
  - ・ YouTube 動画はアドレスをご連絡ください。
- ✓ ロゴおよびオンライン企業展示会は 2024 年 10 月末日まで継続して掲示する予定です。

#### ④ 休憩中スライドショー（ムービー可）

- ✓ 休憩時間、昼食時間（会期中計 6 回程度）にオンライン会議会場メインチャンネルにてスライドショーを放映いたします。パワーポイントの自動プレゼン機能、もしくは動画ムービーを放映可能です。
  - ・ パワーポイントの場合、最大 15 枚程度を目途
  - ・ 動画形式の場合、最長 1 分 45 秒程度を目途
- ✓ ファイル（pptx, mp4 形式など）を担当者にメール添付などによりご送付ください。
- ✓ ご準備が難しい場合は、上記の予稿集広告の原稿を放映させていただくことも可能です。

#### ⑤ オンサイト会場でのポスター掲示・広告配布

- ✓ オンサイト会場（東レ総合研修センター）にて御社の広告ポスター（A0 サイズ）の掲示、A4 広告の配布をさせていただきます。研究会で印刷はできかねますので、ポスター・広告については完成品をご準備の上、郵送いただくようお願いいたします。

=====  
◎申し込み方法：以下の申込内容をご記入いただき、下記の申し込み先までお送りください。

問い合わせ・申込先： EDIT29 副プログラム委員長 大田 晃生（福岡大学）  
E-mail: a\_ohta@fukuoka-u.ac.jp

**お申し込み締切：2023 年 12 月 1 日(金)**

**EDIT29 企業広告・スポンサーシップ申込書**

貴社名 :

ご担当者名 :

部署 :

ご連絡先 :

.....

TEL :

電子メール :